

日月光一〇〇年度第四季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 101 年 2 月 10 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇〇年度第四季及全年獲利報告，本公司一〇〇年第四季之合併營業收入較一〇〇年第三季衰退 1%，較九十九年同期衰退 13%，為新台幣 46,390 百萬元。茲將日月光一〇〇年度第四季單季及全年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	100 年度 第四季	100 年度 第三季	99 年度 第四季	100 年度 全年	99 年度 全年
營業收入	46,390	46,698	53,283	185,347	188,743
營業毛利	8,475	8,912	11,967	35,009	40,545
營業淨利(淨損)	3,501	4,312	7,392	16,821	24,099
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	2,952	4,200	6,892	16,997	22,824
所得稅利益(費用)	(340)	(717)	(1,791)	(3,018)	(3,629)
少數股權純損(益)	27	(15)	(231)	(253)	(857)
本期淨利(淨損)	2,639	3,468	4,870	13,726	18,338
稀釋每股盈餘(元)	0.40	0.52	0.72	2.03	2.73

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	100 年度 第四季	100 年度 第三季	99 年度 第四季	100 年度 全年	99 年度 全年
營業收入	31,908	32,581	32,602	127,623	125,737
營業毛利	6,790	7,319	8,211	28,738	32,064
營業淨利(淨損)	3,156	3,866	4,979	15,328	20,054
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	2,937	4,004	5,652	16,297	20,971
所得稅利益(費用)	(329)	(523)	(655)	(2,330)	(2,171)
少數股權純損(益)	31	(13)	(127)	(241)	(462)
本期淨利(淨損)	2,639	3,468	4,870	13,726	18,338
稀釋每股盈餘(元)	0.40	0.52	0.72	2.03	2.73

半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	56
個人電腦	12
汽車及消費性電子產品	32
其他	0
前十大客戶佔營收比重	51

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	58
歐洲	12
台灣	20
日本	5
亞洲其他地區	5

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced substrate & leadframe based	81
Traditional leadframe based	8
Module assembly	6
Others	5
封裝資本支出金額	81 百萬美元
打線機台數	13,846 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	84
晶圓測試	14
前段測試	2
測試資本支出金額	33 百萬美元
測試機台數	2,585 台

電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	37
電腦產品	24
消費產品	15
工業產品	15
汽車電子產品	9
其他	0
前十大客戶佔營收比重	80
EMS 資本支出金額	8 百萬美元